

AMI 互通性產業標準工作組會議記錄

紀錄：台灣智慧型電網產業協會秘書處

會議時間：104 年 8 月 21 日

出席代表：經濟部標檢局、台灣智慧型電網產業協會、大同股份有限公司、工業技術研究院、中興電工股份有限公司、台灣富士通股份有限公司、四零四科技股份有限公司、玖鼎電力資訊股份有限公司、指旺科技股份有限公司、財團法人台灣電子檢驗中心、財團法人資訊工業策進會、康舒科技股份有限公司、智能電網國際股份有限公司、華新儀錶股份有限公司、意法半導體股份有限公司、達創科技股份有限公司

會議內容：本次工作組會議，目的係辦理先進讀表系統互通性產業標準提案審查會議，並針對 AMI 互通性標準-G3.PLC、AMI 互通性標準-ZigBee Pro 與 AMI 互通性標準- RFC6971 三項提案進行討論。本次會議由提案單位針對 AMI 互通性產業標準工作組之審查意見，進行提案內容之修正與答覆，另由工作組成員針對投票制度與 ZigBee TEST CASE 測試項目切割位元組門檻限制數值進行投票表決。

議題討論：

1. 資策會 G3-PLC 與 ZigBee 提案意見回覆。
2. 投票表決 ZigBee TEST CASE 測試項目切割位元組門檻規範提案。
3. 富士通 RFC6971 提案意見回覆。
4. 臨時動議(邀請台電說明通訊方式、整體佈建狀況)
5. 表決變更投票制度

會議結論：

1. G3-PLC 提案已依照審查委員建議補足安全規範，目前仍在增加章節內容，預計於下次會議草案文件完善後再提交至工作組審查，另以取得 Trialog 測試平台並且順利通過全部共 83 項測試案例。ZigBee 部分依據工作組意見完成互通性規範案例 1.1 版及測試案例草案 1.1 版，並根據實測結果針對 ZigBee TEST CASE 測試項目切割位元組門檻規範提出兩案建議：(1)依循 Texas Instruments 採用 79Bytes 為封包 Fragmentation 大小、(2) 依循 NXP 採用 80Bytes 為封包 Fragmentation 大小。
2. 工作組針對資策會 ZigBee TEST CASE 測試項目切割位元組門檻規範兩項建議進行表決，投票結果兩者均未超過半數，故無法訂定 ZigBee TEST CASE 測試項目切割位元組門檻數值，工作組將依照成員建議規劃於 9 月 AMI 互通性產業標準工作組會議邀請 Texas Instruments 以及 NXP 的專家來針對現有封包切割位元組門檻進行說明與討論。
3. 富士通已回覆審查意見，並表示將提供更完整的網路層協議說明文件。另外，針對工作組進一步提出的三項議題討論進行答覆。

- i. 議題一：關於富士通提供之供應含IEEE802.15.4e與IEEE802.15.4g@2.4GHz的供應商，工作組提出該列項回覆的TI CC2650與Atmel AT86RF215，皆屬IEEE 802.15.4g @2.4G Hz收發器，並未含IEEE 802.15.4e MAC層，並建議協會應確認IEEE 802.15.4 e/g @2.4GHz (MAC/PHY)供應商之議題，同時對於富士通提案之架構仍抱有疑慮。富士通針對此議題表示將補足完整架構圖及相關Layer說明文件以釐清工作組疑慮，並說明已列出的四家IC與富士通提案並不存在互通性問題，預計於下次會議提交補充說明文件。
 - ii. 議題二：目前富士通之路由方法DFF已通過多國/區域的專利審查，成為正式的專利文件。另有研究顯示，DFF路由方法的效能並非最佳。工作組提出以上兩點是否會增加富士通在WiSun聯盟提案(尤其是DFF路由方法)通過成為標準文件的困難度，故建議此提案應等通過WiSun聯盟審查成為正式標準文件之後再行審查。富士通針對此議題表示富士通致力於將路由方法DFF轉為免費標準於未來供廠家使用，並將於會後提供DFF路由方法相關說明文件與該專利釋出的承諾說明。
 - iii. 議題三：富士通應參酌正式標準文件的寫法提出標準文件提案，並補足提案中DFF路由方法部分內容。富士通表示未來會將這部分的文件補齊，再由工作組進一步審理。
4. 採納臨時動議提出的應與台電更新進度、了解台電目前佈建狀況與方向建議，工作組規劃於下次會議邀請台電專家出席說明其未來採納通訊技術的可能發展趨勢。
 5. 針對工作組成員投票資格判定規則異動進行表決，以 10 票通過：未來工作組成員即使缺席仍保有投票資格。(此次表決總票數為 18 票：同意 10 票、不同意 3 票、廢票 5 票)